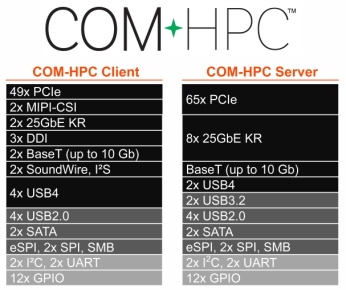
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Domande dei lettori:** | **Contatto Stampa:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.it](http://www.congatec.it) | [info@sams-network.com](mailto:info@prismapr.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



***Il pinout del nuovo standard COM-HPC***

*Testo e foto disponibili presso:* [*https://www.congatec.com/it/congatec/comunicato-stampa.html*](https://www.congatec.com/it/congatec/comunicato-stampa.html)

**Comunicato stampa**

Il lavoro del comitato COM-HPC di PICMG alle battute finali

**Approvato il pinout di COM-HPC**

**Deggendorf, Germany, 20 Novembre 2019** \* \* \* congatec ha annunciato che il comitato tecnico di PICMG che si occupa di COM-HPC ha approvato il pinout di questo nuovo standard per moduli COM (Computer-on-Module) ad alte prestazioni. Il lavoro di definizione dello standard COM-HPC sta entrando nella fase finale che porterà alla ratifica della versione 1.0 delle specifiche, la cui entrata in vigore è prevista per la prima metà del 2020. Produttori di moduli COM e progettisti di schede carrier che fanno parte del gruppo di lavoro di COM-HPC possono quindi iniziare a sviluppare i primi progetti di sistemi di elaborazione per edge computer (ovvero che effettuano elaborazione alla periferia della rete) sulla base di queste specifiche pre-approvate, con l'obiettivo di introdurli sul mercato in contemporanea al lancio delle nuove generazioni di processori embedded di fascia alta da parte di Intel® e AMD del prossimo anno.

Nell'esprimere la propria soddisfazione per i progressi del lavoro relativo alle specifiche COM-HPC Jessica Isquith, presidente di PICMG ha tra l'altro affermato: “All'interno della nostra organizzazione stiamo attivamente lavorando alla definizione dello standard dei moduli COM di prossima generazione, un'attività di fondamentale importanza per il mondo dei sistemi di elaborazione edge ed embedded. Oltre, al footprint, ovvero l'ingombro fisico, il pinout è l'altra pietra miliare delle specifiche. La pre-approvazione del pinout è avvenuta in tempi così rapidi grazie al fatto che siamo riusciti a coinvolgere nel comitato tecnico COM-HPC tutti i principali protagonisti, compresi i produttori di semiconduttori come Intel. In questo modo siamo anche in grado di assicurare la miglior conformità possibile dello standard con i processori delle future generazioni”.

Christian Eder, chairman del comitato COM-HPC, si è detto fiducioso del fatto che le specifiche possano essere ratificate ufficialmente prima che i prossimi processori embedded di fascia alta facciano il loro ingresso sul mercato. “Le definizione delle specifiche di un nuovo modulo COM è un compito complesso – ha sottolineato Eder – che vede coinvolte parecchie parti interessate. Abbiamo iniziato ufficialmente il nostro lavoro a ottobre dello scorso anno e saremo in grado di rilasciare i nuovi moduli COM, le schede carrier e le piattaforme per lo sviluppo soluzioni in contemporanea con l'introduzione sul mercato delle prossime generazioni di processori embedded di fascia alta. L'offerta conforme agli standard COM Express di PICMG andrà così ad ampliarsi con nuove soluzioni che comprenderanno tra l'altro server edge headless, quindi privi di interfaccia utente, e client edge sempre più ricchi di funzionalità”.

Grazie all'adozione di questo pinout, tutti i membri del comitato dispongono di una solida base per poter mettere a disposizione interfacce che supportano fino a 100 GbE e PCIe Gen.4 e 5, oltre a un massimo di 8 zoccoli DIMM e processori ad alta velocità che dissipano potenze superiore a 200 W, su moduli basati su COM-HPC, nonchè lavorare su progetti di schede carrier conformi a questo standard.

Tra i membri del comitato COMM-HPC di PICMG si possono annoverare l'Università di Bielefeld e Adlink, Advantech, Amphenol, AMI, congatec, Elma Electronic, Emerson Machine Automation Solutions, ept, Fastwel, GE Automation, HEITEC, Intel, Kontron, MEN, MSC Technologies, N.A.T., Samtec, SECO, TE Connectivity, Trenz Electronic e VersaLogic. Adlink, congatec e Kontron sono anche sponsor di questo comitato. Christian Eder, direttore marketing di congatec, è il chairman del comitato COM-HPC. In precedenza Eder è stato coinvolto, in qualità di curatore, nello sviluppo dell'attuale standard COM Express. Stefan Milnor (Kontron) e Dylan Lang (Samtec) supportano il lavoro di Eder in qualità rispettivamente di editor e segretario del comitato COM-HPC di PICMG.

Maggiori informazioni sul nuovo standard COM-HPC per moduli COM e il relativo pinout sono disponibili all'indirizzo: <https://www.congatec.com/COM-HPC>

**Chi è congatec**  
Fortemente orientata allo sviluppo tecnologico, congatec è un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni di elaborazione embedded. I moduli di elaborazione a elevate prestazioni della società sono utilizzati in una vasta gamma di dispositivi e applicazioni destinati ai settori dell'automazione industriale, della tecnologia medicale, dei trasporti e delle telecomunicazioni, oltre che in numerosi altri mercati verticali. congatec è l'azienda leader a livello globale nel comparto dei moduli COM (Computer-on-Module) è può vantare una base di clienti ampia e diversificata, che spazia dalle start-up alle più importanti realtà multinazionali. Fondata nel 2004, congatec ha il proprio quartier generale a Deggendorf, Germania e ha fatto registrare nel 2018 un fatturato pari a 133 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito web [www.congatec.com](http://www.congatec.com/) oppure tramite via [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) e [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.*